М.В. ВОРОПАЕВ*, **, Д.Д. КАРИМБАЕВ*, А.И. КОХ*, А.П. КОХАНЕНКО**

РАЗРАБОТКА МОЩНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ВАКУУМИНЫХ КАМЕР

Представлены результаты теплового расчета светодиодного модуля и экспериментальные измерения температуры светового модуля в вакууме.

Ключевые слова: тепловой анализ, температура, программный комплекс ANSYS, степень черноты.

Введение

В настоящее время светодиодные источники белого света широко используются для бытовых и промышленных задач. При практическом использовании таких источников для работы на атомных электростанциях (АЭС) возникает целый ряд особых требований к конструкции и материалам, используемым при создании полупроводникового светильника [1, 2].

Ядерные изотопы на АЭС находятся в специальных вакуумных камерах. При разработке систем освещения в этих камерах необходимо учитывать, что корпус светового модуля должен быть из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с низкой теплопроводностью и отвод тепла от источника света, находящегося в вакууме, будет происходить только за счёт теплового излучения. Кроме этого, задаются требования и к основным параметрам полупроводникового светильника: излучаемый световой поток не менее 3000 Лм; температура *p*-*n*-перехода светодиодных кристаллов не более +60 °С; масса источника света должна быть не более 6 кг.

Модель единичного светодиодного элемента

При разработке полупроводникового светильника за основу была взята светодиодная матрица, изготавливаемая в НИИПП, электрическая мощность 40 Вт (светоотдача матрицы 100 Лм/Вт). Для повышения отвода тепла от светодиодной матрицы в работе предлагается использовать чернение внутренней части корпуса светильника. На рис. 1 представлена модель единичного светово-

го элемента матрицы, используемая при проведении расчетов в программном комплексе ANSYS [3, 4]. Поток тепла поступает от светодиодного кристалла, размещенного на керамической пластине (нитрид алюминия) с помощью токопроводящей пасты DIMAT, которая, в свою очередь, крепится с помощью припоя на пластину из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Расчеты температурных полей единичного светового элемента проводились с учетом конкретных значений параметров материалов, используемых при разработке светодиодных модулей (таблица). На внутренней поверхности вакуумной камеры степень черноты выбиралась 0.9, на внешней поверхности 0.08 (рис. 1), а на светодиодный кристалл с размерами 1×1 мм подается электрическая мощность 0.3 Вт (КПД 50 %).



Рис. 1. Модель единичного светодиодного элемента: 1 – поверхность светодиодного кристалла (площадь теплового потока); 2 - поверхность со степенью черноты 0.9; 3 – поверхность со степенью черноты 0.08

Проведенные расчеты температурных полей единичного светодиодного элемента светового модуля с помощью программного комплекса ANSYS позволяют провести оптимизацию размеров (площади и толщины) теплорассеивающего основания из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, приходящегося на один кристалл (рис. 1).

Наименование основных элементов	Толщина слоя	Теплопроводность материала,
		Bt/(m·°C)
Светодиодный кристалл InGaN 1×1 мм	100 мкм	65
Токопроводящая паста для посадки кристалла	20 мкм	60
Металлизация	7 мкм	360
Керамика (AlN) 30×30	0.45 мм	150
Припой	20 мкм	65
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	0.7-3 мм	15

Параметры элементов в модели единичного светодиодного элемента светового модуля

Экспериментальные исследования

На рис. 2 представлены зависимости распределения температуры теплорассеивающего основания единичного светодиодного элемента светового модуля от толщины пластины, а на рис. 3 – результаты расчетов температуры p–n-перехода светодиодного кристалла единичного светодиодного элемента светового модуля от площади теплорассеивающего основания. На основе полученных результатов с учетом требований по ограничению температуры p–n-перехода светодиодного кристалла светодиодного кристалла (+60 °C) и минимизации размеров и веса разрабатываемого светильника были выбраны размеры теплорассеивающего основания из нержавеющей стали 12X18H10T, приходящегося на один светодиодный кристалл светового модуля 30×30×1.5 мм.



240 220 200 180 160 140 u-d 120 100 80 60 40 2 10 4 8 S, CM

Рис. 2. Распределение температуры по поверхности теплорассеивающей площадки единичного светодиодного элемента светового модуля от толщины пластины, мм: кр. 1 - 0.7; кр. 2 - 1.5; кр. 3 - 2; кр. 4 - 3

Рис. 3. Зависимость температуры *p*-*n*-перехода светодиодного кристалла единичного светодиодного элемента светового модуля от площади теплорассеивающего основания

На рис. 4 представлены рассчитанные зависимости температуры p-n-перехода светодиодного кристалла единичного светодиодного элемента матрицы от степени черноты внутренней поверхности теплорассеивающего основания с выбранными ранее оптимальными размерами основания. Можно отметить сильную зависимость температуры p-n-перехода от степени черноты внутренней поверхности теплорассеивающего основания. Результаты этого расчета показывают, что только при выборе максимального чернения внутренней поверхности теплорассеивающего основания внутренней поверхности теплорассеивающего основания. Результаты этого расчета показывают, что только при выборе максимального чернения внутренней поверхности теплорассеивающего основания мы можем получить температуру p-n-перехода светодиодного кристалла менее 60 °C.

Экспериментальные измерения зависимостей температуры теплорассеивающего основания при помощи термопары от тока, подаваемого на каждый светодиодный кристалл, проводились на экспериментальном макете светового модуля, состоящем из 5 светодиодных кристаллов. Размеры экспериментального светового модуля и параметры его элементов полностью соответствовали значениям, используемым ранее при расчетах размеров (площади и толщины) теплорассеивающе-

го основания из нержавеющей стали 12X18H10T, приходящегося на один кристалл. Измерения проводились при комнатной температуре.

На рис. 5 представлены четыре кривые зависимости температуры теплорассеивающего основания от тока через светодиодный кристалл для следующих случаев:

кр. *1* – измерения проводились на воздухе без чернения внутренней поверхности подложки;

кр. 2 – измерения проводились в вакууме (1–20 Па) без чернения внутренней поверхности подложки;

кр. 3 – измерения проводились на воздухе при чернении внутренней поверхности подложки;

кр. 4 – измерения проводились в вакууме (1–20 Па) при чернении внутренней поверхности подложки.



Рис. 4. Зависимость температуры *p*-*n*-перехода светодиодного кристалла единичного светодиодного элемента матрицы от степени черноты внутренней поверхности теплорассеивающего основания



Рис. 5. Экспериментальные измерения зависимостей температуры теплорассеивающего основания от тока через *p*-*n*-переход светодиодного кристалла

Представленные экспериментальные измерения подтверждают результаты расчетов о необходимости чернения внутренней поверхности теплорассеивающего основания светодиодного модуля при работе источника света в вакуумной камере. С учетом того, что работа источника света планируется в вакуумной камере при температуре не ниже 30 °C, был выбран максимальный ток, который можно подавать на каждый светодиодный кристалл (150 мА).

Заключение

Таким образом, на основе представленных в работе теоретических расчетов и экспериментальных результатов была разработана конструкция светильника со световым потоком не менее 3000 Лм, температурой корпуса источника света не выше +60 °C и массой не более 4 кг для работы в вакуумной камере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Свитнёв Ю Теплоотвод в современных осветительных системах: решение Fischer // Новости электроники + светотехника. 2011. № 10. С. 4–5.
- Миранович В., Филоненко И. Мощные светодиоды: особенности применения, проблемы и методы решение на примере светодиодов компании PROLIGHT OPTO TECNOLOGY. // Электронные компоненты. 2007. № 6. С. 45–49.
- 3. Капулин А.Б., Морозова Е.М., Олфёрова М.А. ANSYS в руках инженера: практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. 272 с.
- 4. Босов К.А. ANSYS: справочник пользователя. М.: ДМК-Пресс, 2005. 640 с.

*ОАО НИИПП, г. Томск, Россия

Поступила в редакцию 25.09.14.

**Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия E-mail: koh@mail.tsu.ru

Воропаев Михаил Владимирович, аспирант, мл. науч. сотр.; Каримбаев Дамир Джамулетдинович, зав. лабораторией; Кох Александр Иванович, инженер;

Коханенко Андрей Павлович, д.ф.-м.н., профессор.

M.V. VOROPAEV*, **, D.D. KARIMBAEV*, A.I. KOH*, A.P. KOHANENKO**

DEVELOPMENT POWER SEMICONDUCTOR FIXTURES FOR THE VACUUM CHAMBER

The results of thermal calculation of the LED module and experimental measurements of the temperature of the light module in a vacuum

Keywords: thermal analysis, temperature, software package ANSYS, the degree of blackness.

REFERENCES

- 1. Svitnev Yu. Teplootvod v sovremennyh osvetitelnyh sistemah: rechenie Fischer. *Novosti elektroniki+svetotechnica*, 2011, № 10, pp. 4–5.
- 2. Miranovich V. and Filonenko I. Moshnye svetodiody: osobennosti primenenia, problemy I metody rechenia na primere svetodiodnoi companii PROLIGHT OPTO TECNOLOGY. *Elektronnye componenty*, 2007, no. 6, pp. 45–49.
- 3. Kapelin A.B., Morozova E.M., and Olferova M.A. ANSYS v rurach inzenera: Prakticheckoe rukovodstvo. Moscow, Editorial URSS Publ., 2003, 272 p.
- 4. Bosov K.A. ANSYS: spravochnic polzovatelya. Moscow, DMK-Press, 2005, 640 p.

*OAO NIIPP, г. Tomsk, Russia **National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia E-mail: koh@mail.tsu.ru

Karimbayev Damir Dzhamuletdinovich, head of the laboratory;

Koch Alexander Ivanovich, engineer;

Voropaev Mikhail Vladimirovich, graduate student;

Kokhanenko Andrey Pavlovich, Dr.Sci., professor.